



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 背板引导硬件



背板引导硬件类型: 导套模块

背板引导位置: 前板

产品特性

产品类型特性

ATCA 模块代码	K1/K2
背板引导硬件类型	导套模块

结构特性

键控 + 极化位置	6, 8
PCB 安装方向	直角
背板引导位置	前板

主体特性

导轨元件电镀材料	镍
导轨元件基材	锌合金

接触件特性

端子接触部电镀材料	镍
-----------	---

机械附件

导轨硬件	不带
------	----

包装特性

封装数量	1
封装方法	Package

其他

注释	不提供硬件。
----	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 6-1469372-8

ATCA GUIDE MODULE RA MALE

客户还购买了





TE 产品编号66506-9

PIN CONTACT, 20 DF





TE 产品编号2007174-2

SFP 1x6 Light Pipe Assy, Reduced Length





TE 产品编号2007169-1

SFP 1x6 cage Assm Light Pipe, EMI gasket





TE 产品编号2007626-1

1x4 QSFP Kit Assy Sqr LP, SAN Htsnk



TE 产品编号2198230-1
SFP+ Enhanced 1x2, PCI Heatsink



TE 产品编号1934349-1
TinMan R/A Header Assy 5x8 Open



TE 产品编号3-582119-9
TEST PROBE REC130 TRI-MT WHT GPBR



TE 产品编号2302791-2
VERTRECCASSY,CENTER,RTM, MULTIGIG RT3

文档

产品图纸

ATCA GUIDE MODULE RA FEMALE

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1469373-8_E.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1469373-8_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1469373-8_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD_6-1469373-8_041820181411_dmtec

英文版本

MD_6-1469373-8_041820181411_dmtec

英文版本